

STRONGER
TOGETHER

Conference of Science & Technology for Integrated Circuits (CSTIC) 2025

March 24-25, 2025

www.semiconchina.org/cstic v.semi.org.cn/cstic



SEMICON[®]
CHINA

CSTIC 2025 Grand Opening



CSTIC 2025 Plenary Session

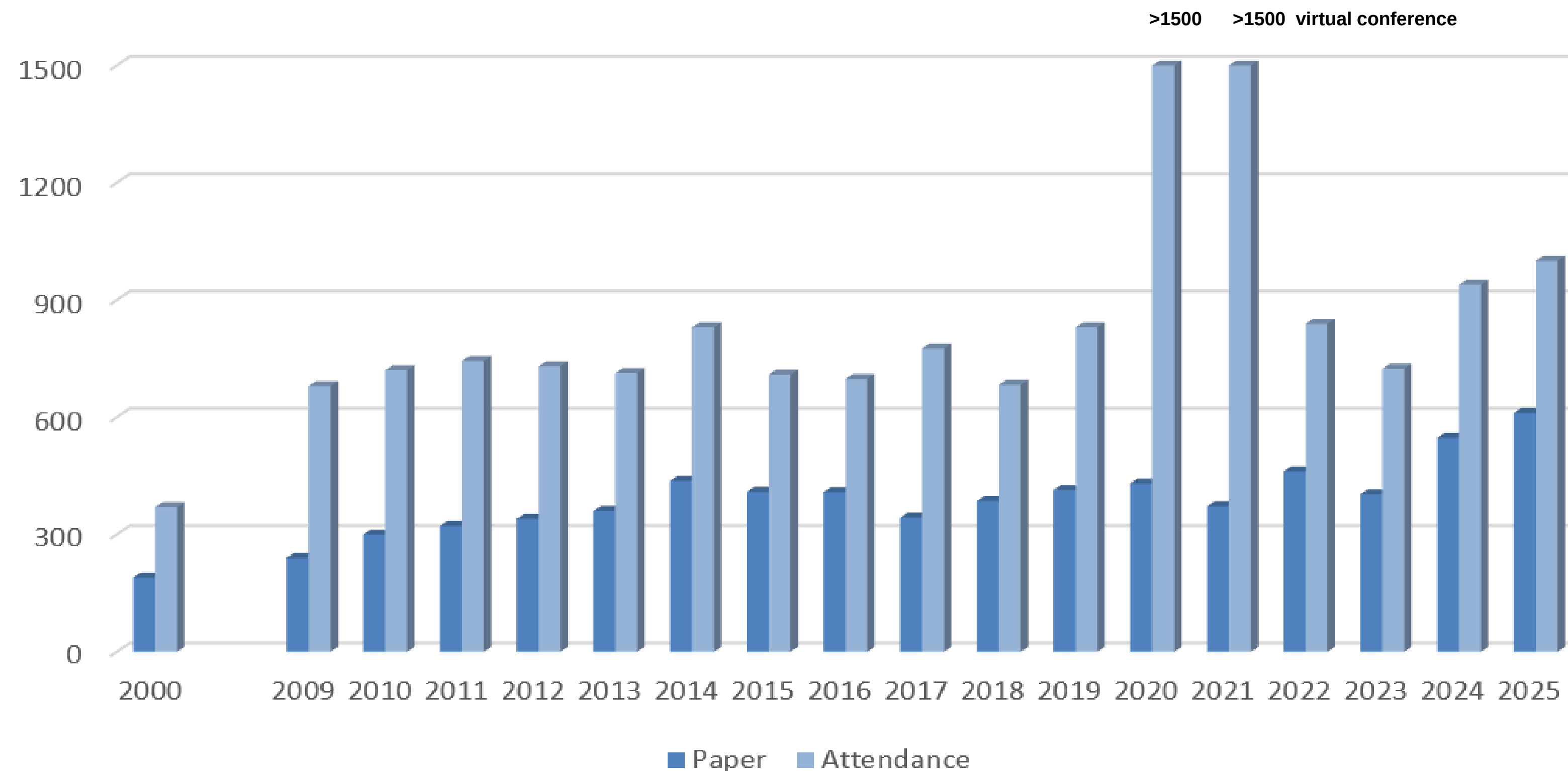


10 Symposiums, Panel Discussion, Tutorials and Poster Session



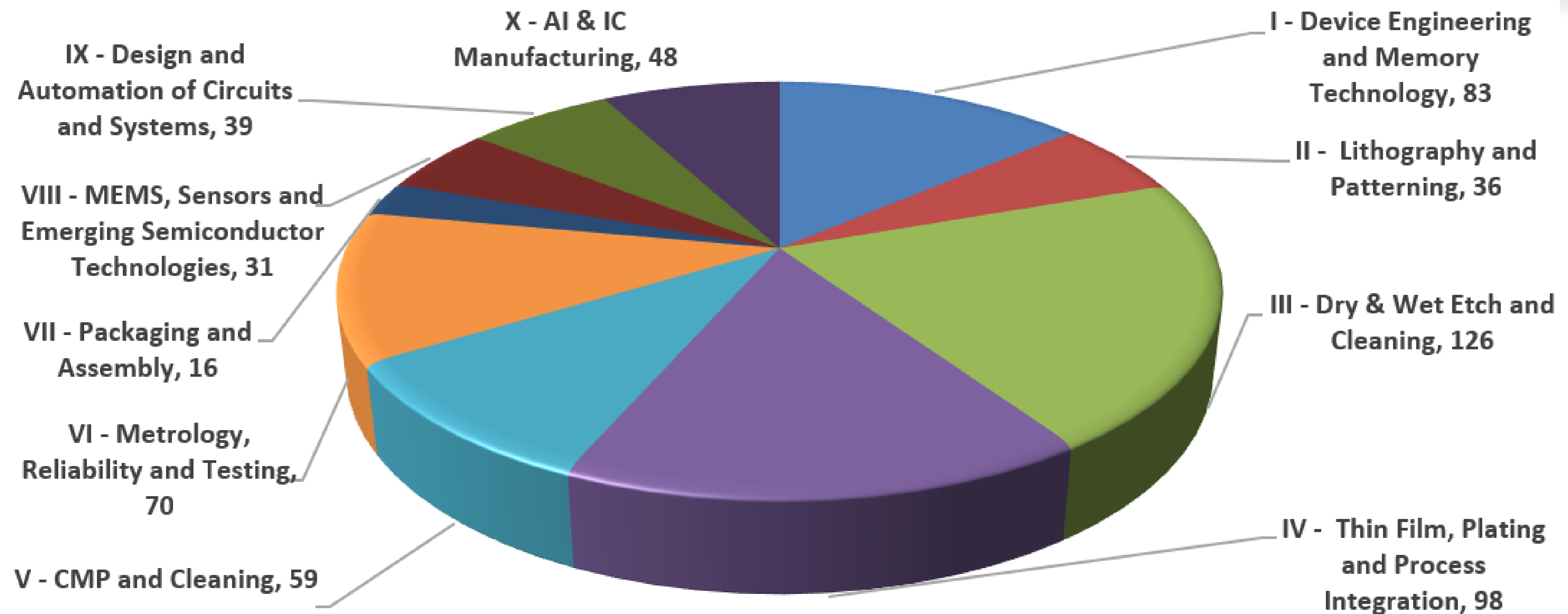
CSTIC 2025 Data

- Largest and most comprehensive, influential annual industrial semiconductor technology conference in China and Asia
- **611 abstracts** have been collected, while **1000 registered attendees** joined the onsite conference. Both the numbers have broken **CSTIC's record**. Speakers and attendees came from more than 18 countries and districts, including Belgium, Canada, England, France, Germany, Israel, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Netherlands, Russia, Singapore, Sweden, US, Uzbekistan, Hongkong China, Taiwan China and etc.

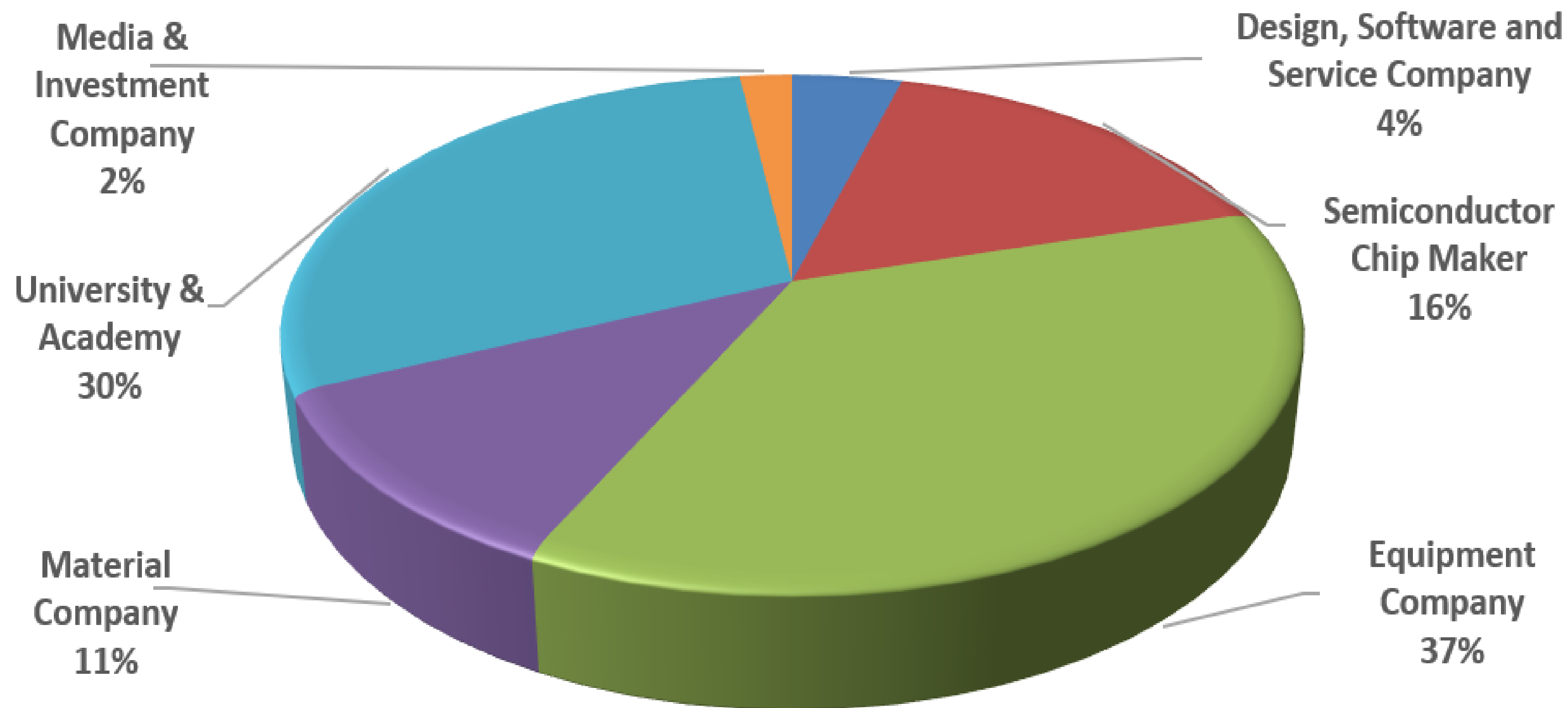


CSTIC 2025 Symposiums

Top 3 abstract submission symposiums are III, IV and I



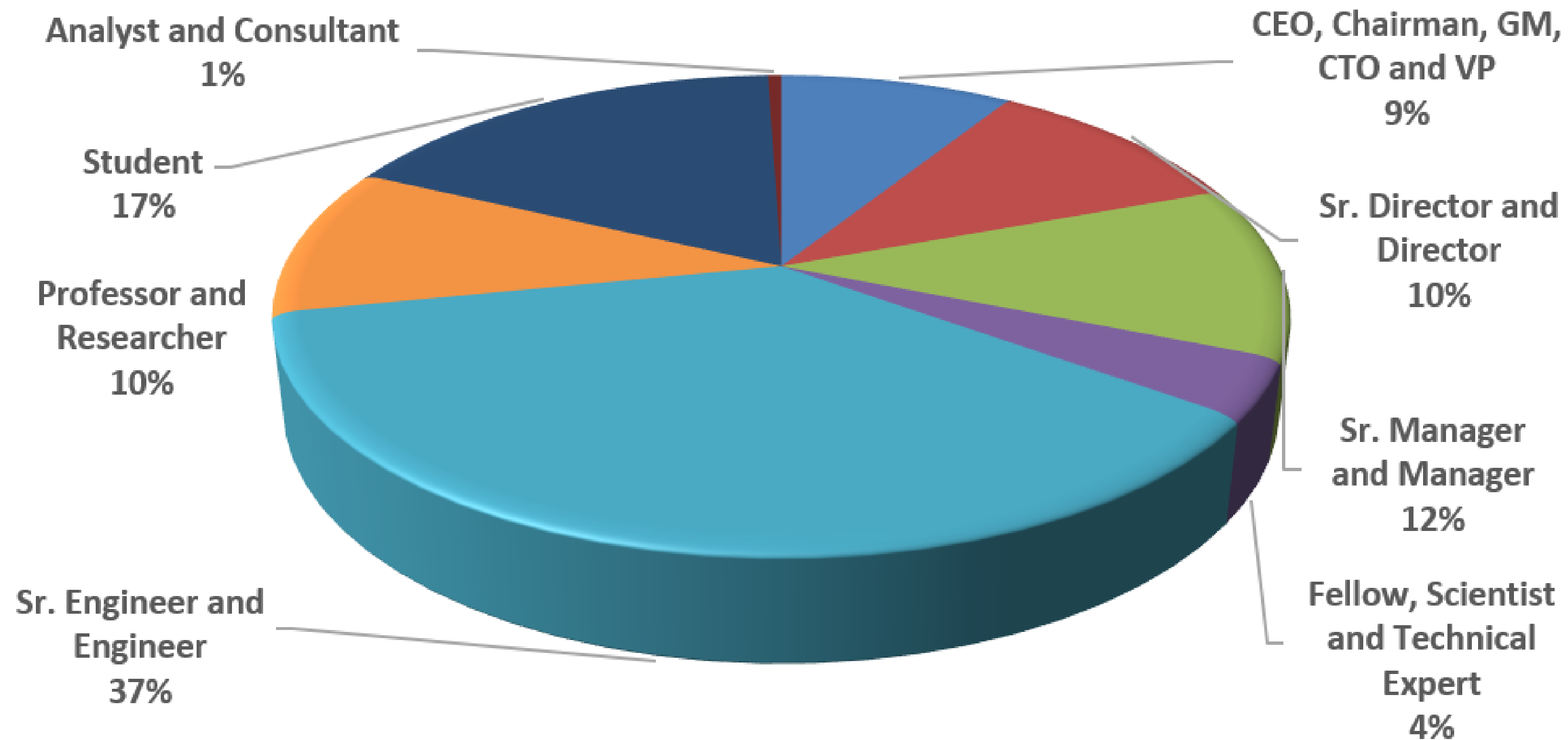
CSTIC 2025 Attendees



- 70% attendees from industry, while 30% from universities and institutes



CSTIC 2025 Attendees' Job Title



- 31% of the attendees were managers or above, who were the decision makers in companies.

Attendees from 295 Companies, Universities and Institutes

ABB
 Advantest
 AMEC
 Anhui Chunyuan
 Anji
 Applied Materials
 ASM
 ASML
 Beijing Naura Microelectronics
 BEST
 Biosensors
 Bonotec Electronic Materials
 Brewer Science
 Cadence Design System Inc.
 Carl Zeiss
 China University of Mining and Technology-Beijing
 CUHK
 D2S Inc.
 Darlian University of Technology
 DuPont
 East China Normal University
 Eastern Institute of Technology, Ningbo
 Edwards
 Elevate Semiconduct Inc
 Forschungszentrum Juelich
 FT Device
 Fudan University
 FUJIFILM Electronic Materials
 GHS Semiconductor
 Global Research & Innovative Solutions Co.,Ltd.
 .

GrandiT Co., Ltd.
 Hangzhou Cobetter Filtration Equipment Co., Ltd
 Hebei University of Technology
 Hitachi High-Tech (Shanghai)
 HONEYWELL
 Hongkong University of Science and Technology
 Huali Microelectronics Corporation
 Huawei
 Huawei Hong Kong Research Center
 Hwatsing Technology
 IBM
 ICT, CAS
 IMECAS
 Infinitesima Ltd
 Institute of Semiconductors, CAS
 Instontech
 Intel
 ITW
 JCET
 JCET Semiconductor Intergation (Shaoxing) Co., Ltd.
 JSR Corporation
 KAIST
 Key Laboratory of MEMS of the Ministry of Education, Southeast University
 KLA
 KLIC
 KU Leuven
 Lam Research
 Leadmicro
 Materials Design Inc.
 Microsoft

Morgan Stanley
 Moses Lake (Dalian) Chemical Industries
 MYCRONIC
 Nanjing University
 Nanyang Technological University
 National Chiao Tung University
 National Taiwan Central University
 NICIC
 NIKON CORPORATION
 Nova Ltd
 NTS
 NXP Semiconductors
 Onto Innovation
 Ostec-EC
 Peking University
 Physical-Technical Institute of Uzbekistan Academy of Sciences
 PIOTECH
 PRIMARIUS, Shanghai
 Promisense Electronic Technology Co., Ltd.
 Qualcomm
 Quantica Computing, LLC
 Raintree Scientific Instruments (Shanghai) Co.
 Reexen Technology
 Rieger Strategic Innovation
 Sai Microelectronics
 SAMSUNG SDI
 SAMT
 Sanechips
 Shanghai Jiao Tong University
 Shanghai Tech University

Attendees from 295 Companies, Universities and Institutes

Shenzhen University
SiEn(Qingdao)Integrated Circuits
Singapore University of Technology and Design
SMEE
Southeast University
Southwest China Institute of Electronics Technology
Sungkyunkwan University
Suzhou Runbang Semiconductor Material Technology
Tokyo Electron
TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD
Toray Advanced Materials Research Labo.
Toray Industries Inc.
Tsinghua University
ULVAC
University of Leicester
University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute
W.L Gore
Yangtze Memory Technology
Yantai Xianhua
YUANTA SECURITIES KOREA
Yuan-Ze University
Zhejiang Jingsheng M&E Co.
Zhejiang University
澳汰尔
巴陵华兴石化
北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司
北京电子信息技术学院
北京高盟新材料股份有限公司
北京航空航天大学
北京集成电路装备创新中心有限公司

北京科百特过滤器材有限公司
北京首都科技项目经理人管理有限公司
北京新忆科技有限公司
北京信息科技大学
北京屹唐半导体科技股份有限公司
北京银行上海分行
博纳半导体设备（浙江）有限公司
蔡司（上海）管理有限公司
常州诸善科技有限公司
成都海光集成电路设计有限公司
大尘微影
东方晶源微电子（北京）股份有限公司
东莞理工学院
东莞忆联信息系统有限公司
东京工业大学
东丽分析技术开发（上海）有限公司
东南大学
杜邦特用产品
杜邦中国研发中心
方正证券
方舟互联（深圳）私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）
福建晋华集成电路股份有限公司
复旦大学
富士胶片电子材料（香港）有限公司上海代表处
戈尔（深圳）有限公司
光跃投资
广东工业大学
广州富乐德科技
广州友思特科技有限公司
国际量子研究院

國立中央大學
哈尔滨工业大学
海光集成电路设计（北京）有限公司
海光云芯集成电路设计（上海）有限公司
海南三花私募基金
海思技术有限公司
合肥晶合集成电路有限公司
合肥尚合芯科技有限公司
合肥欣奕华智能机器股份有限公司
河北工业大学
湖北鼎汇微电子材料有限公司
湖南大学
华东师范大学
华海清科股份有限公司
华虹半导体(无锡)有限公司
华虹宏力半导体
华利集成电路制造有限公司
华美半导体协会
华南理工大学
华为技术投资有限公司
华芯（嘉兴）智能装备有限公司
华芯投资管理有限责任公司
华胥基金
华中科技大学
華為香港研究所
江苏微导纳米科技股份有限公司
京东方科技集团股份有限公司
京隆科技

Attendees from 295 Companies, Universities and Institutes

晶合集成
科磊半导体设备技术（上海）有限公司
科林研发股份有限公司
兰州理工大学
凌云光技术股份有限公司
鲁汶仪器
洛阳中硅高科技有限公司
马波斯（上海）测量设备科技有限公司
梅特勒-托利多
摩西湖（大连）化学工业有限公司
默克
南方科技大学
南京大学
南京高华科技股份有限公司
内蒙古大学
宁波大学
牛尾贸易（上海）有限公司
鹏城实验室
浦宸基金
青岛海存微电子有限公司
清华大学深圳国际研究生院
清软微视（杭州）科技有限公司
全芯智造技术有限公司
三井化学
厦门半导体工业技术研发有限公司
上海谙邦半导体设备有限公司
上海彩迓文生化科技有限公司
上海飞埃技术有限公司
上海复享光学股份有限公司
上海光电科技创新中心

上海衡滨电子有限公司
上海华虹宏力半导体制造有限公司
上海华为技术有限公司
上海集成电路材料研究院有限公司
上海集成电路创新中心有限公司
上海交通大学
东方理工高等研究院
上海科技大学
上海盛芯通泰
上海天承化学有限公司
上海微崇半导体设备有限公司
上海微电子装备（集团）有限公司
绍兴文理学院
深圳国际量子研究院
深圳市埃芯半导体科技有限公司
深圳市海思半导体有限公司
深圳市基石化学有限公司
深圳市新凯来工业机器有限公司
深圳市中兴微电子技术有限公司
深圳先进电子材料国际创新研究院
深圳智现未来工业软件有限公司
深圳中科飞测科技股份有限公司
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
思锐智能
苏州全芯光科技有限公司
苏州实验室
苏州思体尔软件科技有限公司
苏州佑伦真空设备科技有限公司
苏州源展材料科技有限公司
拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司

拓荆科技(上海)有限公司
腾讯科技公司
天准科技
微电子研究所
潍坊星泰克微电子材料有限公司
卫利国际科贸（上海）有限公司
无锡华瑛微电子技术有限公司
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
西安电子科技大学
香港科技大学
香港科技大学（广州）
芯栋微（上海）半导体技术有限公司
芯恩（青岛）集成电路有限公司
芯鑫融资租赁有限责任公司
新微资本
星展银行
燕麦（杭州）智能制造
益联资本
钢泰科技
钢泰科技（苏州）有限公司
源资科技
粤芯半导体技术股份有限公司
张江国家实验室
长存集团创新研究院
长电科技管理有限公司
长江存储科技有限责任公司
长鑫存储技术有限公司
长鑫科技集团股份有限公司

浙江大学杭州国际科创中心
浙江大学-上虞半导体材料研究中心
浙江钱塘基础科学研究院
浙江省发展规划研究院
浙江省发展和改革委员会
浙江省经济信息中心
浙江御辰东智能科技有限公司
之江实验室
中国电科
中国电子工程设计院
中国电子科技集团公司第二研究所
中国工程院战略咨询中心
中国科学技术大学
中国科学院金属研究所
中国科学院微电子研究所
中国矿业大学（北京）
中晶新源（上海）半导体有限公司
中科飞测
中山大学
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
中芯京城
珠海基石科技有限公司
紫光国芯
字节跳动
(株)トリケミカル研究所

CSTIC 2025 Distinguished Conference Plenary Speakers



Dr. Giri Nallapati
Vice President of Technology
Qualcomm Inc., USA



Dr. Edmundo A. Gutiérrez D.
General Director
INAOE, Mexico



Dr. Tim Kwang-Ting Cheng
Vice-President for Research and
Development
The Hong Kong University of
Science and Technology, China



Mr. Terrance Lee
Corporate Vice President, GM
Applied Materials, USA

9:25-10:00 Heterogeneous Computing Solutions for Power-Performance Efficient On-Device AI

Dr. Giri Nallapati, Vice President of Technology, Qualcomm Inc., USA

10:00-10:35 From the Nanometer Scale to Light Years

Dr. Edmundo A. Gutiérrez D., General Director, INAOE, Mexico

10:35-11:10 Chip Design for AI and AI for Chip Design

Dr. Tim Kwang-Ting Cheng, Vice-President for Research and Development, The Hong Kong University of Science and Technology

11:10-11:45 Materials Engineering Innovations to Address Next-Gen Electronics Packaging Challenges

Mr. Terrance Lee, Corporate Vice President, GM, Applied Materials, USA

10 Symposia with >100 Invited Speakers

Symp I: Device Engineering and Memory Technology

Symp. II: Lithography and Patterning

Symp. III: Dry & Wet Etch and Cleaning

Symp. IV: Thin Film, Plating and Process Integration

Symp. V: CMP and Cleaning

Symp. VI: Metrology, Reliability and Testing

Symp. VII: Packaging and Assembly

Symp. VIII: MEMS, Sensors and Emerging Semiconductor Technologies

Symp. IX: Design and Automation of Circuits and Systems

Symp. X - AI & IC Manufacturing

Virtual Conference: April 2-30 v.semi.org.cn/cstic



Prof. Qing-Tai Zhao
Senior Research Scientist
Forschungszentrum Jülich |
Peter Grünberg Institute, Germany



Dr. Hongjie Liu
Founder, Chairman and CEO
Reexen Technology Co., Ltd.,
China



Mr. Michael Rieger
Chief Technologist
Synopsys (retired), USA



Mr. Robert Eklund
Product Manager
Mycronic AB, Sweden



Dr. Zhongwei Jiang
Deputy General Manager of EtchII BU
Beijing NAURA Technology Group
Co., Ltd., China



Dr. Masaru Izawa
Senior Chief Engineer
Hitachi High-Tech Corporation,
Japan



Dr. David (Wei) Zou
Senior Director
Applied Materials,
USA



Prof. Haitao Ye
Professor of Materials Engineering,
Director of Research
University of Leicester, UK



Dr. Xinchun Lu
Chairman of the Board, Chief
Scientist
Hwatsing Technology Co. Ltd.,
China



Dr. Taesung Kim
Professor and Dean of College of
Engineering
Sungkyunkwan University, Korea



Prof. David Keezer
Chair Professor
Eastern Institute of Technology,
China



Dr. Siqun Xiao
Senior Director
Applied Materials,
China



Dr. Yee Sin Ang
Assistant Professor
Singapore University of Technology
and Design, Singapore



Prof. Heejun Yang
Professor
Korea Advanced Institute of
Science and Technology, Korea



Prof. Yier Jin
Professor
University of Science and
Technology of China



Prof. Yungang Bao
Professor, Deputy Director
Institute of Computing Technology
(ICT), Chinese Academy of Sciences
(CAS), China



Dr. Wenliang Dai
Founder & CEO
Xpedic, China



Prof. Michael Kraft
Full Professor of Micro- and
Nanosystems
University of Leuven, Belgium

Panel Discussion

16:30-18:00, Monday, March 24, 2025

Industry-University Co-Play for IC Chips: Challenges, Opportunities, and Prospects

Moderator:

Panelists:



Prof. Chen Wang
Associate Professor
Tsinghua University



Dr. Hongjie Liu
Founder, Chairman and CEO
Reexen Technology



Prof. Qiang Wu
Professor
Fudan University



Dr. Xinchun Lu
Chairman and Chief Scientist
Hwatsing Technology



Dr. Zongliang Huo
CTO
Yangtze Memory Technology



Dr. Yuan Lu
VP and Chief Scientist
Sai Microelectronics



SEMI U Tutorial: Workforce Development Training Courses

Topic: Photolithography and Related Technologies and Process Standards

Speaker: Dr. Qiang Wu, Professor of the School of Microelectronics of Fudan University

Topic: Advanced Package and 3DIC (Chipselets and HBM)

Speaker: Dr. Guorong Li, Vice President, Beijing NAURA Technology Group Co., Ltd.

Dr. Xia Jiang, Chief Scientist, JCET SEMICONDUCTOR INTEGRATION (SHAOXING) CO., LTD.



Conference Executive Committee Members



Dr. Beichao Zhang
Conference Chair
VP of Hangzhou HFC,
China



Prof. Bin Yu
Conference Executive Co-
Chair
Professor, Zhejiang
University, China



Dr. Peng Bai
Conference Co-Chair
President, HHGrace, China



Prof. Cor Claeys
Conference Co-Chair and
Award Selection Chair
Professor, KU Leuven,
Belgium



Dr. Steve X. Liang
Conference Co-Chair and
Symp-VII Chair



**Prof. Qianqian Huang
(acting)**
Symp-I Chair
Professor, Peking
University, China



Dr. Linyong (Leo) Pang
Symp-II Chair
Vice President, D2S Inc.,
USA



Dr. Ying Zhang
Symp-III Chair
Consultant



Dr. Xiaoping Shi
Symp-IV Chair
CTO, Beijing Naura
Microelectronics, China



Prof. Xinping Qu
Symp-V Chair
Professor, Fudan
University, China



Dr. Xiaowei Li
Symp-VI Chair
Deputy Director, ICT, CAS,
China



Prof. Jianshi Tang
Symp-VIII Chair
Associate Professor,
Tsinghua University, China



Prof. Pingqiang Zhou
Symp-IX Chair
Associate Professor,
Shanghai Tech University,
China



Prof. Cheng Zhuo
Symp-X Chair
Professor,
Zhejiang University, China



Dr. Hsiang-Lan Lung
Poster Chair
Director, MXIC, Taiwan,
China

Special Thanks to Sponsors and Co-organizer

Sponsors:



Organizer:



Co-organizer:



Co-sponsor:



CSTIC 2026 Call for Papers

Time: March 22 ~ 23, 2026

CSTIC 2026 call for papers and manuscript deadlines:

Abstract Due:	Sep. 30, 2025	Copyright Due:	Feb. 10, 2026
Author Notification:	Oct. 15, 2025	Presentation Due:	Feb. 20, 2026
Manuscript Due:	Dec. 15, 2025	Conference Date:	<u>Mar. 22-23, 2026</u>



STRONGER
TOGETHER

Thank you.